



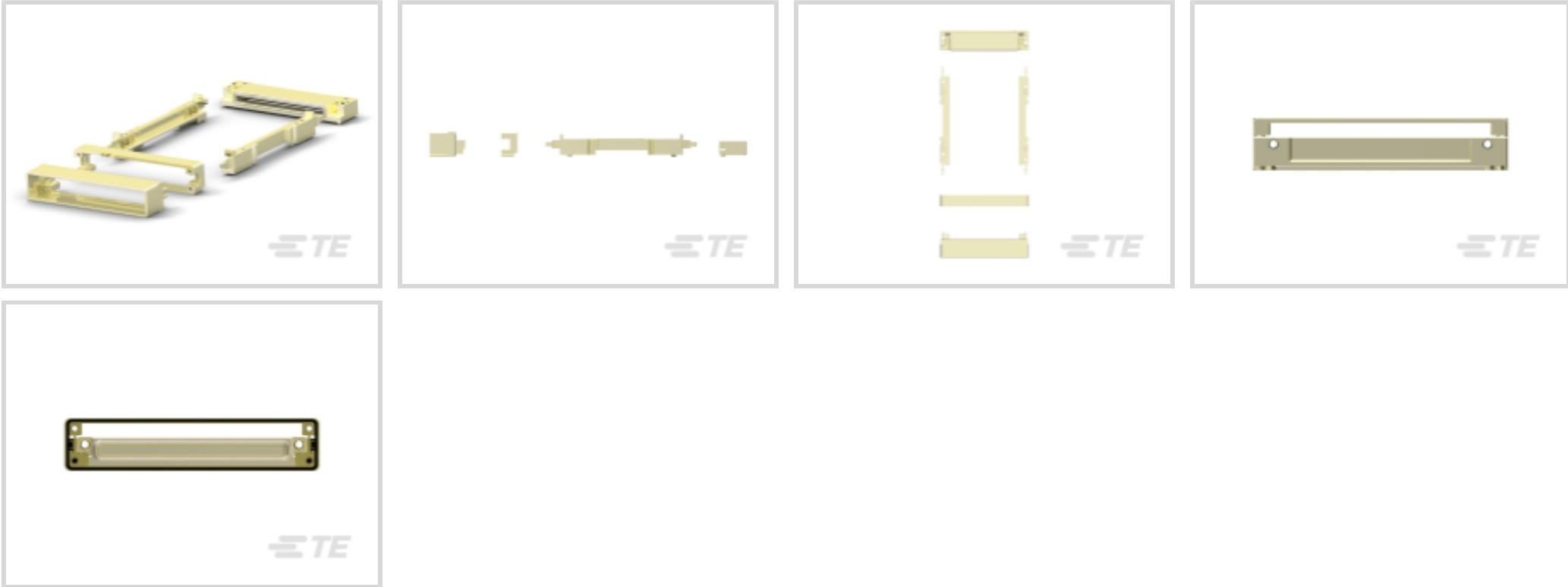
CFP

TE 内部编号 2227675-1

CFP, CFP/CFP2/CFP4, Accessory, Port Matrix Configuration 1 x 1, Data Rate (Max) 100 Gb/s, Double-Sided (Belly-to-Belly)

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 插拔式连接器和笼子 > CFP/CFP2/CFP4



插拔式 I/O 产品类型: 附件

端口矩阵配置: 1 x 1

数据速率（最大值）: 100 Gb/s

PCB 安装方式: 双面（前部对前部）

产品特性

产品类型特性

外形尺寸	CFP
插拔式 I/O 附件类型	硬件套件
笼子类型	单
插拔式 I/O 产品类型	附件

结构特性

端口矩阵配置	1 x 1
--------	-------

电气特征

数据速率（最大值）	100 Gb/s
-----------	----------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 螺钉
----------	---------

机械附件

PCB 安装方式	双面（前部对前部）
----------	-----------

尺寸

PCB 厚度（建议）	2 mm[.079 in]
------------	---------------



操作/应用

兼容的散热器	否
适用于插拔式 I/O 产品	CFP 组件

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

注释	套件包含 2 条导轨、1 个连接器盖组件、1 个垫板组件和 1 个外部支架组件
----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | CFP



客户还购买了





文档

产品图纸

CFP HW Kit, No HS, No Clips

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2227675-1_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2227675-1_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2227675-1_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本